

<<电镀配合物>>

图书基本信息

书名：<<电镀配合物>>

13位ISBN编号：9787122011077

10位ISBN编号：7122011070

出版时间：2008-1

出版时间：7-122

作者：方景礼

页数：720

字数：1019000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电镀配合物>>

内容概要

配位剂（旧称络合剂）是电镀溶液中的基本成分，对电镀过程和电镀层质量有很大影响。本书对配合物的基本原理、配位平衡、配合物的平衡电位及电化学、各种配合物以及电镀溶液的配方设计等进行了系统阐述，对配合物在镀前预处理、各镀种工艺、镀层退除、镀层防变色处理中的应用及强螯合剂废水的处理进行了全面介绍。

附录中提供了电镀配合物的各种数据。

本书可供电镀开发和科研工作者参考，可供电镀工艺设计和操作的技术人员参考；也可作为配化学和电镀工艺基础课程参考书。

<<电镀配合物>>

作者简介

方景礼教授，1940年生，福建省建瓯市人。
南京大学化学系教授。

1957年考入南京大学化学系，师从中国科学院院士戴安邦教授，1965年研究生毕业后留校任教。
1995~2002年应邀到新加坡高科技公司（Gul Tech）任首席工程师，新加坡柏士胜化学公司（Plaschem）任首席技术执行

<<电镀配合物>>

书籍目录

第一章 表面处理在国民经济中的作用第二章 配合物的基本概念第三章 配位平衡第四章 复杂体系的配位平衡第五章 配位反应动力学第六章 配合物的平衡电位第七章 配合物的动力学活性与电极过程第八章 配离子电极反应的速率第九章 多元离子缔合物第十章 混合物配合物第十一章 表面活性配合物第十二章 多元配合物第十三章 电镀理论的发展第十四章 电镀溶液的西方设计与配合物第十五章 电镀工艺的综合指标及其内在规律第十六章 金属离子配位体的选择与分类第十七章 脱脂去污工艺与配合物第十八章 电化学抛光与配合物第十九章 电镀铜配合物第二十章 化学镀铜配合物第二十一章 电镀镍与化学镀镍配合物第二十二章 电镀锌配合物第二十三章 电镀镉配合物第二十四章 电镀铬配合物第二十五章 镀锡与锡合金配合物第二十六章 电镀贵金属配合物第二十七章 镀层退除配合物第二十八章 金属表面配合物保护膜第二十九章 强螯合剂废水的处理方法附录参考文献后记

<<电镀配合物>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>